



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204462903 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 08

(21) 申请号 201520117577. 0

(22) 申请日 2015. 02. 27

(73) 专利权人 记忆科技(深圳)有限公司

地址 518057 广东省深圳市南山区蛇口后海大道东角头厂房 D22/F、D13/F、D23/F、D14/F、D24/F、D15/F

(72) 发明人 余进升 谢可可

(74) 专利代理机构 广东广和律师事务所 44298

代理人 叶新民

(51) Int. Cl.

G05D 23/30(2006. 01)

G11C 29/00(2006. 01)

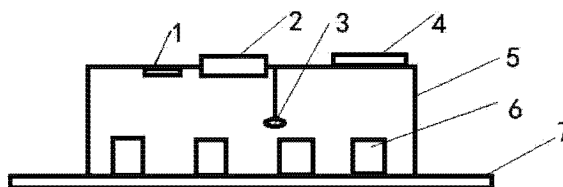
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种内存测试加温盖

(57) 摘要

本实用新型公开了一种内存测试加温盖,其特征包括有隔热材料制成的盖主体,所述盖主体为一面开口的长方体,在盖主体上设有排风风扇,盖主体内壁上设有加热电模块,还包括温度传感器和主控板,所述温度传感器设置在盖主体内,所述主控板设置在盖主体外,所述排风风扇、加热电模块和温度传感器都与主控板电连接。通过采用加温盖可独立对待测试内存进行单独加热,对服务器主板上的其它部件没有影响,并且整体使用灵活,能耗低,采用多个加温盖可满足同时不同的待测试内存进行不同的耐温测试需求,极大提高了测试效率和降低了测试成本。



1. 一种内存测试加温盖,其特征在于包括有隔热材料制成的盖主体,所述盖主体为一面开口的长方体,在盖主体上设有排风风扇,盖主体内壁上设有加热电模块,还包括温度传感器和主控板,所述温度传感器设置在盖主体内,所述主控板设置在盖主体外,所述排风风扇、加热电模块和温度传感器都与主控板电连接。

2. 根据权利要求 1 所述的内存测试加温盖,其特征在于所述温度传感器悬空设置在盖主体内的中心位置。

3. 根据权利要求 2 所述的内存测试加温盖,其特征在于主控板上还设有蜂鸣器报警电路和温度显示面板。

4. 根据权利要求 3 所述的内存测试加温盖,其特征在于还包括适配底盖,所述适配底盖为与盖主体的开口相匹配,可安装在所述开口上,所述适配底盖上还设有可将待测试的内存置入盖主体内的适配口。

一种内存测试加温盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子设备制造领域,具体涉及内存测试设备。

背景技术

[0002] 在内存制造领域,现有技术中制造厂对内存产品质量测试检验使用的加热方案一般都是在高温房和高温柜中进行,这样生产测试设备投放费用是巨大的,并且无法同时对不同产品采用不同的温度进行测试检验;并且这类加热设备是将测试主板整体一起长时间处于高温房和高温柜的高温环境下,这样就会导致主板或其它结构件的加速老化,很大程度上减少了整机的使用寿命。同时这类加热设备的能源损耗也是巨大的,即便是只需测试一台机器也要启动整个高温房和高温柜,存在巨大能源浪费,同时这种高温环境下也提高了测试人员的操作难度和风险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是,如何提供一种可灵活实现只对主板上的待测内存进行局部加热实现单独对待测内存进行高温老化的测试设备。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型设计了一种内存测试加温盖,其特征包括有隔热材料制成的盖主体,所述盖主体为一面开口的长方体,在盖主体上设有排风风扇,盖主体内壁上设有加热电模块,还包括温度传感器和主控板,所述温度传感器设置在盖主体内,所述主控板设置在盖主体外,所述排风风扇、加热电模块和温度传感器都与主控板电连接。

[0005] 所述的内存测试加温盖,其特征在于所述温度传感器悬空设置在盖主体内的中心位置。

[0006] 所述的内存测试加温盖,其特征在于主控板上还设有蜂鸣器报警电路和温度显示面板。

[0007] 所述的内存测试加温盖,其特征在于还包括适配底盖,所述适配底盖为与盖主体的开口相匹配,可安装在所述开口上,所述适配底盖上还设有可将待测试的内存置入盖主体内的适配口。

[0008] 实施本实用新型具有如下有益效果:通过采用加温盖可独立对待测试内存进行单独加热,对服务器主板上的其它部件没有影响,并且整体使用灵活,能耗低,采用多个加温盖可满足同时不同的待测试内存进行不同的耐温测试,极大提高了测试效率和降低了测试成本。

附图说明

[0009] 图 1 是内存测试加温盖的结构示意图;

[0010] 图 2 是增加了适配底盖的内存测试加温盖的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 图 1 是内存测试加温盖的结构示意图,包括有隔热材料制成的盖主体 5,所述盖主体 5 为一面开口的长方体,也可以是其它带有空腔的箱体形状,在盖主体 5 上设有排风风扇 2,盖主体 5 内壁上设有加热电模块 1,还包括温度传感器 3 和主控板 4,所述温度传感器 3 悬空设置在盖主体 5 内的中心位置,所述主控板 5 设置在盖主体 5 外,所述排风风扇 2、加热电模块 1 和温度传感器 3 都与主控板 4 电连接。内存测试加温盖盖在待测试主板 7 上,待测试内存 6 通过盖主体的开口刚好伸入到盖主体 5 内部。

[0013] 图 2 是增加了适配底盖的内存测试加温盖的结构示意图,为了进一步提高内存测试加温盖对不同主板上安装有不同数量,不同规格的内存的测试需求,增加设置了适配底盖 8,根据不同的主板类型可设置多种不同适配口 9 的适配底盖 8。

[0014] 具体工作时,选择合适的内存测试加温盖,内存测试加温盖将待测试的内存盖在盖主体内,通过主控板的面板设置好当前测试所需要的温度;通过温度传感器探测当前的测试温度,如果判定到当前温度低于所设定的温度,则控制加热电模块加热操作,当检测到当前温度达到设定的温度,则控制加热电模块停止加热操作;当检测到当前温度超过设定的温度,则控制排风风扇,进行排风降温操作,当检测到当前温度低于设定的温度,则控制排风风扇停止排风操作。

[0015] 以上所揭露的仅为本实用新型一种实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于实用新型所涵盖的范围。

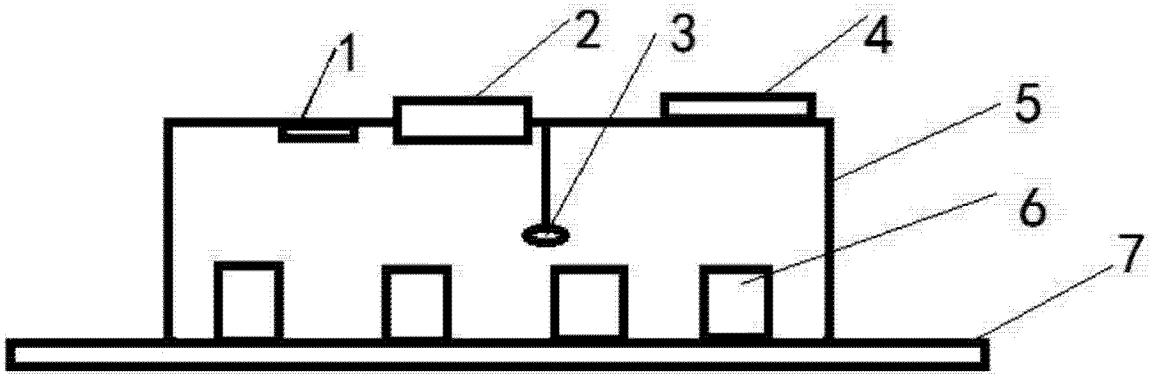


图 1

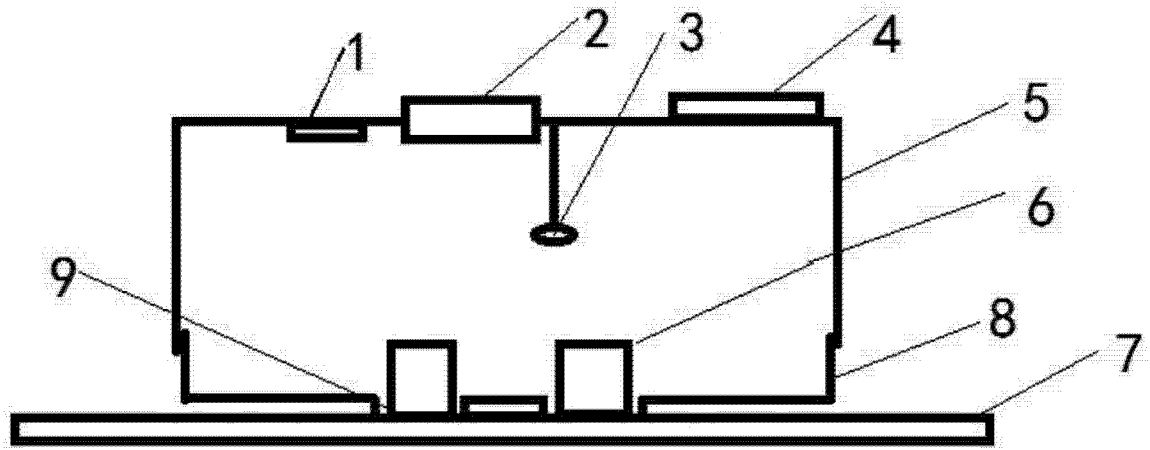


图 2